



华虹宏力收购华力微获上交所通过，磷 化钼需求旺盛龙头密集扩产

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年06月22日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

华虹宏力购买华力微97.49%股权相关事项获上交所审核通过

华虹宏力6月18日公告，公司拟通过发行股份方式向上海华虹有限公司等购买华力微98.8%股权，并募集配套资金。根据该公司的重组报告书，本次交易全部以股份支付，发行价格为43.34元/股，合计发行约1.907亿股，对应交易对价82.68亿元。华虹同步推进配套资金募集，上限为75.56亿元，其中约32.95亿元用于华力微技术升级改造，其中现有产线设备升级改造7.65亿元，BSI项目新建25.30亿元；约5.62亿元用于特色工艺研发及产业化，重点发展BCD工艺，丰富工艺平台；其余资金用于补充流动资金和偿还债务。

AI算力爆发正推动光通信核心材料磷化铟（InP）进入超级需求周期。

AI算力爆发正推动光通信核心材料磷化铟进入超级需求周期。作为光芯片的关键衬底，磷化铟承担着电光信号高效转换的“卡脖子”环节，目前80%以上的需求来自AI数据中心，据LightCounting数据，其2025年占光芯片市场58%的份额，到2031年市场规模将达约69亿美元。产业层面，全球龙头正密集扩产：Coherent基于全球首个量产6英寸磷化铟晶圆厂启动扩建，并获英伟达20亿美元战略投资及长期采购协议，同时取得美国《芯片与科学法案》5000万美元联邦拨款；JX金属计划到2030财年投资1200亿日元将产能提升7至10倍；AXT将募资的6.325亿元用于支持子公司北京通美扩产，当前订单积压已超1亿美元；Lumentum则推进约40%的扩产计划，预测到2030年AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达85%。

建议关注：华虹宏力、华润微、云南锗业。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-06-22 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
002428.SZ	云南锗业	100.44	0.03	0.41	0.94	3348.00	244.98	106.85	未评级
688347.SH	华虹宏力	277.81	0.01	0.51	0.83	27781	544.73	334.71	增持
688396.SH	华润微	73.59	0.54	0.84	1.16	136.28	87.61	63.44	增持

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期，港股股价和EPS货币单位为港元）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

6月15日-6月19日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，大立光领涨，涨幅为29.23%，思佳讯跌幅为2.05%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.O	英特尔(INTEL)	美国	6730.32	-2520.72	6.04	7.56
	QCOM.O	高通(QUALCOMM)	美国	2383.20	43.01	8.74	6.80
	AMD.O	超威半导体(AMD)	美国	8762.36	202.13	13.59	5.04
	NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	美国	50986.98	42.47	26.08	2.68
存储	MU.O	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	12788.39	149.76	17.65	15.52
模拟	TXN.O	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	2938.33	59.09	17.51	7.22
	ADI.O	亚德诺(ANALOG)	美国	2116.20	93.33	6.27	3.99
	AVGO.O	博通(BROADCOM)	美国	19570.31	84.62	22.32	7.66
	NXPI.O	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	790.92	39.13	7.24	2.76
射频	SWKS.O	思佳讯(SKYWORKS)	美国	108.97	22.84	1.89	-2.05
	QRVO.O	QORVO	美国	86.62	25.55	2.59	-0.17
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	696.73	419.71	3.92	1.41
	ON.O	安森美半导体(ON SEMI CONDUCTOR)	美国	476.63	393.91	6.53	4.14
I							
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	6794.97	31.94	3.68	29.23
半导体设备	AMAT.O	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	4899.60	70.01	20.49	8.79
	LRCX.O	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	4865.22	90.80	45.96	6.14
	KLAC.O	科天半导体(KLA)	美国	3390.57	83.48	58.15	1.97
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	7599.67	67.50	31.66	3.55
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	5307.06	72.58	5.68	28.47
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	763408.80	36.82	10.61	4.33
G							
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	2238.41	132.15	5.47	4.55
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	903.23	69.99	8.26	6.40
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	118.99	20.83	1.76	2.61
	AVT.O	安富利(AVNET)	美国	75.03	31.23	1.51	0.97

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

6月15日-6月19日当周，申万半导体指数整体呈现震荡上升的态势。6月18日，申万半导体指数为12009.21，周涨幅为17.76%。

图表3：2000~2026年申万半导体指数

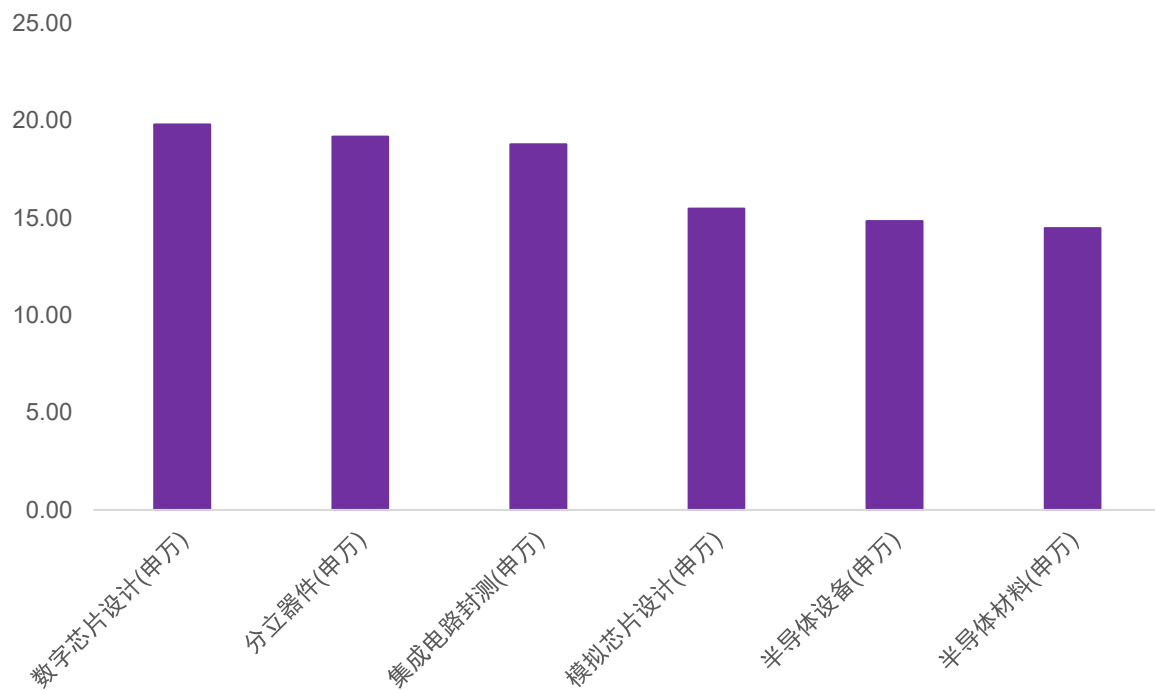


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

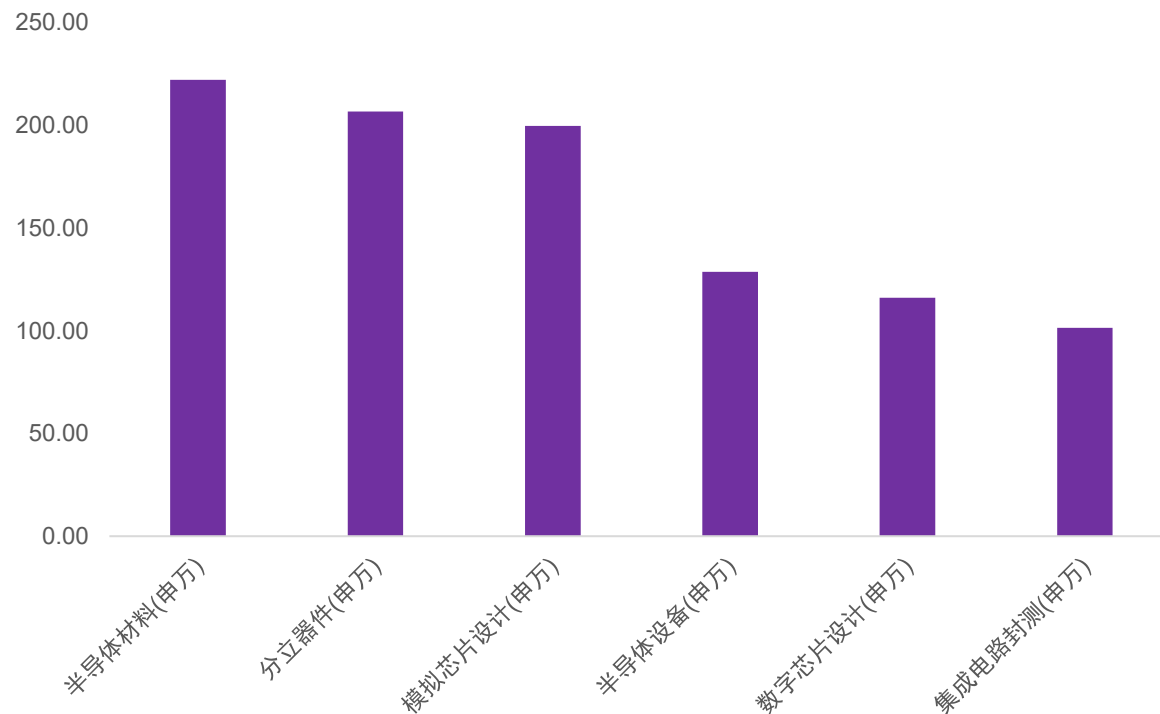
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，6月15日-6月19日当周，半导体细分板块呈上涨态势。其中，数字芯片设计板块涨幅最大，达到19.80%；半导体材料板块涨幅最小，达到14.48%。估值方面，半导体材料、分立器件、模拟芯片设计板块估值水平位列前三。

图表4：6月15日-6月19日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：6月19日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

计算机设备板块主力净流入30.90亿元，主力净流入率为1.80%，在9个二级子行业中排第1名；航天装备板块主力净流出10.61亿元，主力净流入率为-1.84%，在9个子行业中排第9名。

图表6：6月15日-6月19日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW计算机设备	5,901,171.88	5,592,203.80	308,974.81	1.80	4
SW消费电子	25,719,035.55	24,881,941.93	837,093.62	1.42	2
SW其他电子II	7,645,139.58	7,402,453.51	242,686.07	1.36	4
SW其他电源设备II	5,031,224.99	4,927,463.68	103,761.31	0.78	1
SW通信设备	60,433,745.95	59,517,768.93	915,977.02	0.76	1
SW半导体	103,530,589.69	102,744,042.41	786,547.28	0.35	-1
SW军工电子II	6,902,078.23	6,931,548.77	-29,470.54	-0.15	-1
SW电子化学品II	14,310,508.14	14,697,718.35	-387,210.21	-1.11	-1
SW航天装备II	1,439,321.60	1,545,430.58	-106,108.98	-1.84	-4

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

6月15日-6月19日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：普冉股份、科翔股份，锆威特，长信科技，雅创电子，兴森科技，香农芯创，裕太微-U，兆易创新，精研科技，周涨幅分别为：51.05%，45.05%，43.79%，39.01%，37.86%，37.72%，35.93%，33.78%，30.64%，30.34%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值（亿元）	EPS			PE			PB	周涨跌幅（%）
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688766.SH	普冉股份	877.35	1.40	3.96	-	396.40	209.89	-	32.47	51.05
300903.SZ	科翔股份	442.27	-0.59	0.31	0.82	-166.59	330.89	123.98	24.22	45.05
688693.SH	锆威特	59.77	-1.32	-	-	-61.48	-	-	7.52	43.79
300088.SZ	长信科技	259.01	0.08	0.17	0.27	107.63	59.54	37.95	3.03	39.01
301099.SZ	雅创电子	136.87	0.86	2.61	4.32	88.33	35.74	21.55	9.54	37.86
002436.SZ	兴森科技	884.85	0.08	0.26	0.44	-850.93	202.02	118.77	16.74	37.72
300475.SZ	香农芯创	1196.72	1.17	2.36	3.47	172.16	108.89	74.15	24.26	35.93
688515.SH	裕太微-U	191.04	-1.67	-1.42	0.09	-142.85	-167.58	2729.14	13.02	33.78
603986.SH	兆易创新	4476.34	2.47	3.10	8.71	266.87	216.46	73.21	17.84	30.64
300709.SZ	精研科技	117.34	0.28	3.15	-	173.78	20.02	-	5.44	30.34

资料来源：wind，华鑫证券研究

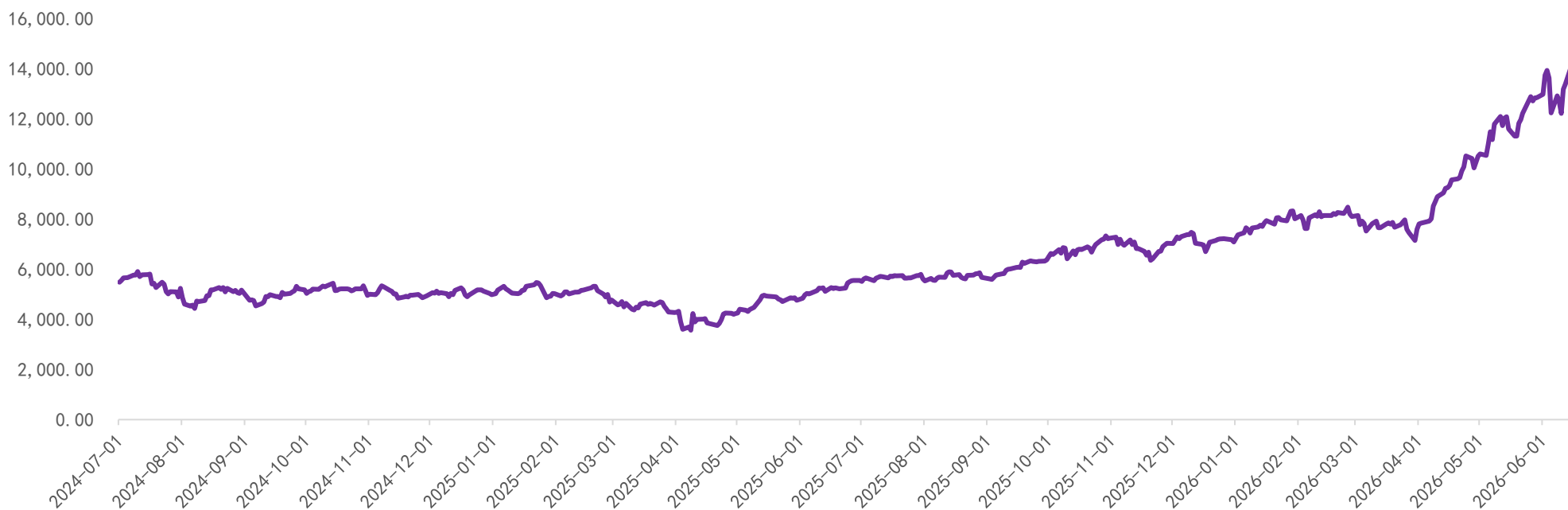
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，6月15日-6月19日当周，费城半导体指数总体呈现震荡上升的态势。在2026年6月16日出现大幅回调至13,294.22点；随后两个交易日连续反弹，6月18日收于14,341.78点，创近两周以来新高。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。2026年二季度，指数延续上行趋势，6月中旬在短暂回调后再度走强，刷新阶段高点。

图表8：费城半导体指数近两年走势

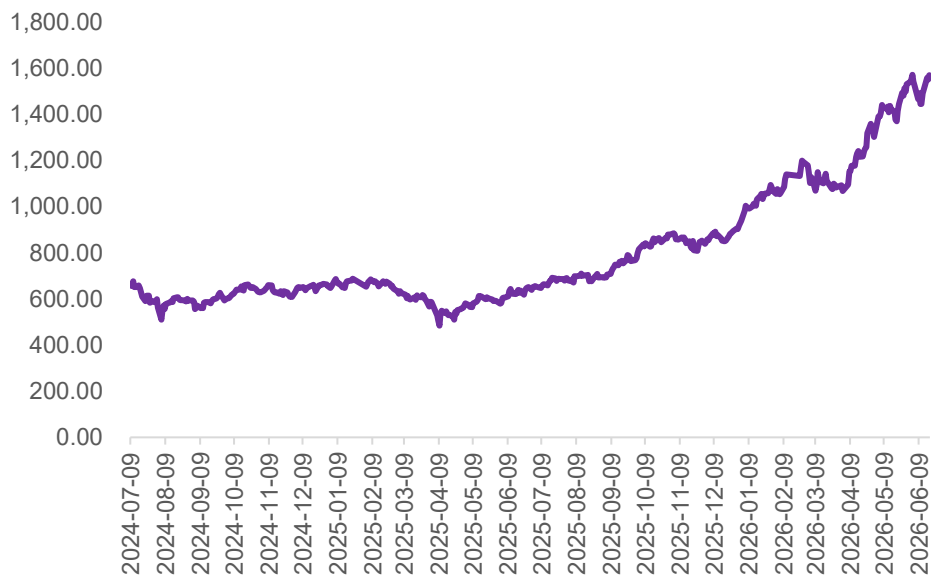


资料来源：wind，华鑫证券研究

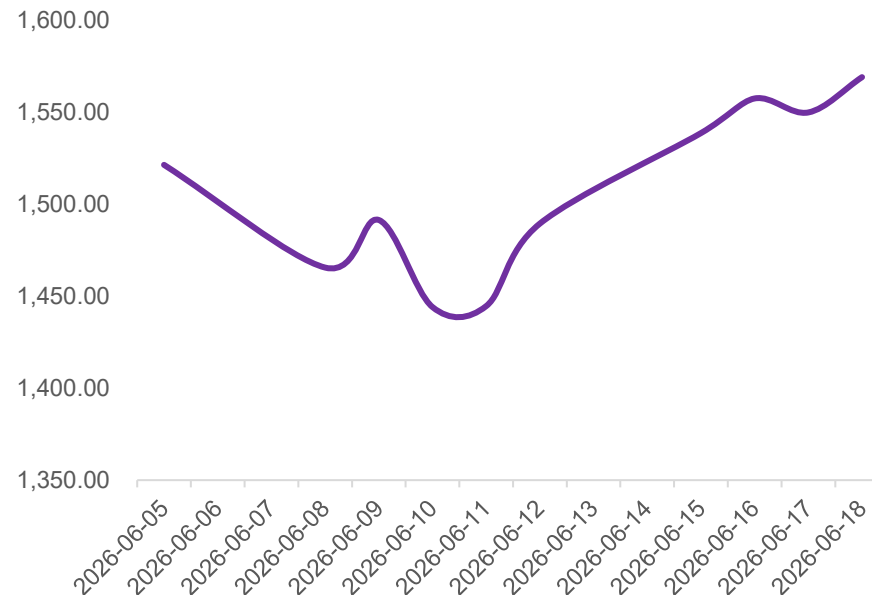
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，6月8日-6月19日两周，台湾半导体行业指数呈现整体上升的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。2026年指数延续上行走势，6月中旬在短暂回调后再度走强，不断刷新阶段高点。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



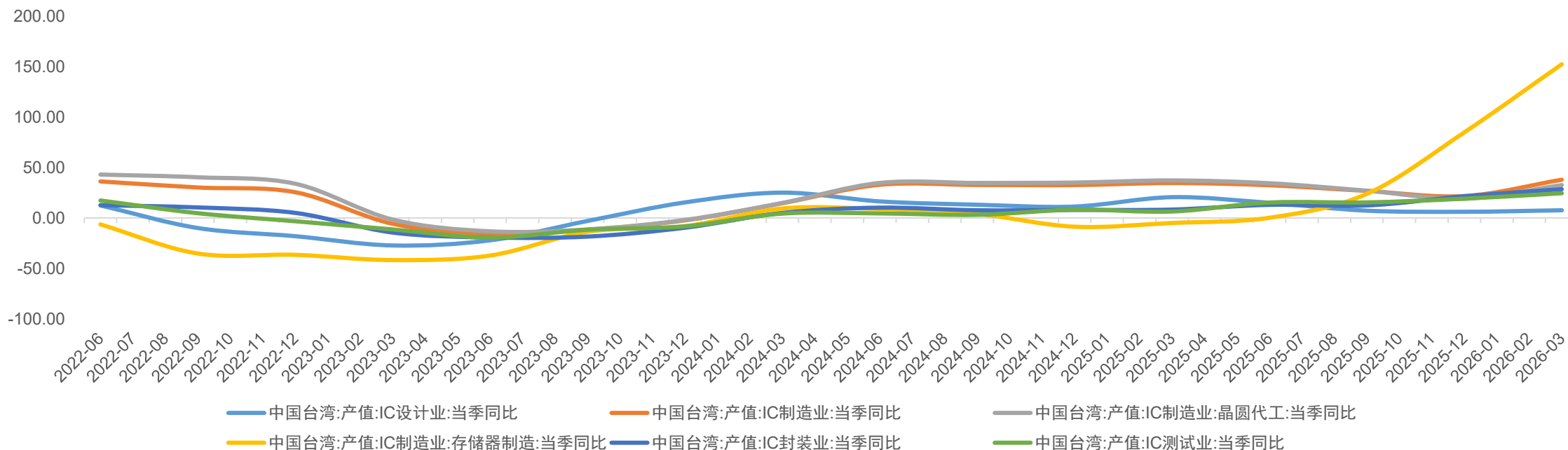
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹。IC板块整体表现不佳导致2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。2026年一季度，中国台湾IC各板块产值同比增速全面上行。在AI算力需求持续旺盛及存储器行业周期复苏的推动下，2026年Q1中国台湾IC产业景气度显著上行。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

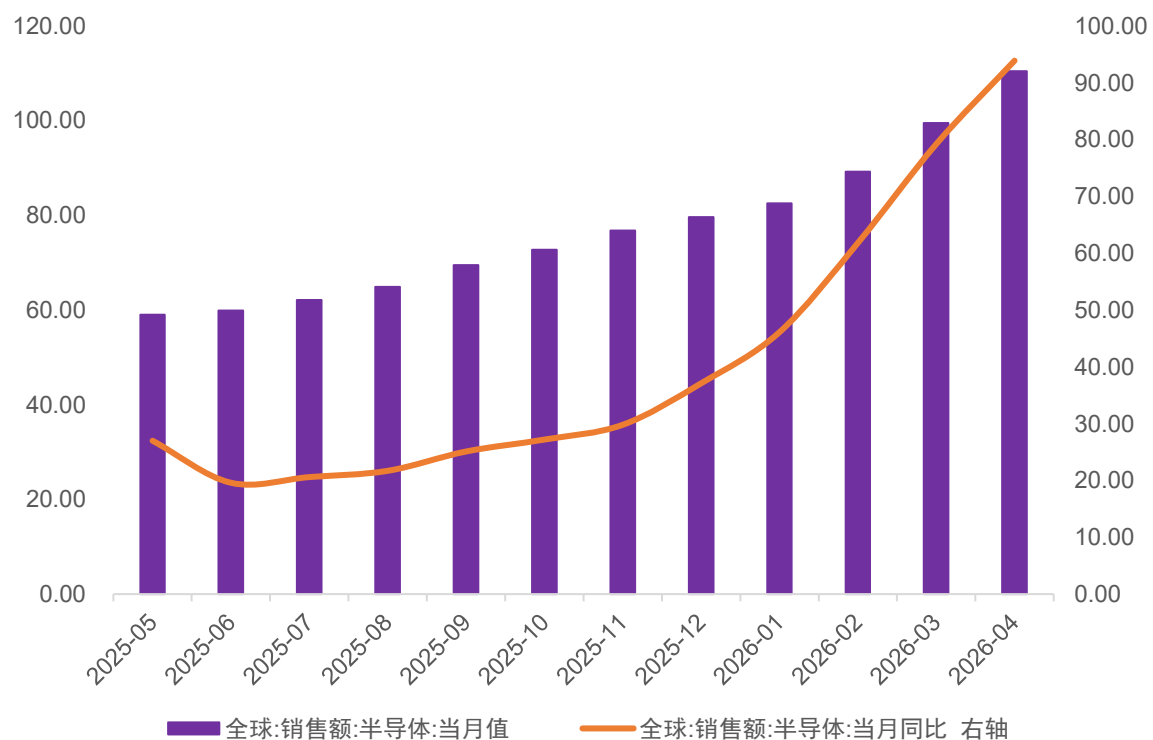


资料来源：wind，华鑫证券研究

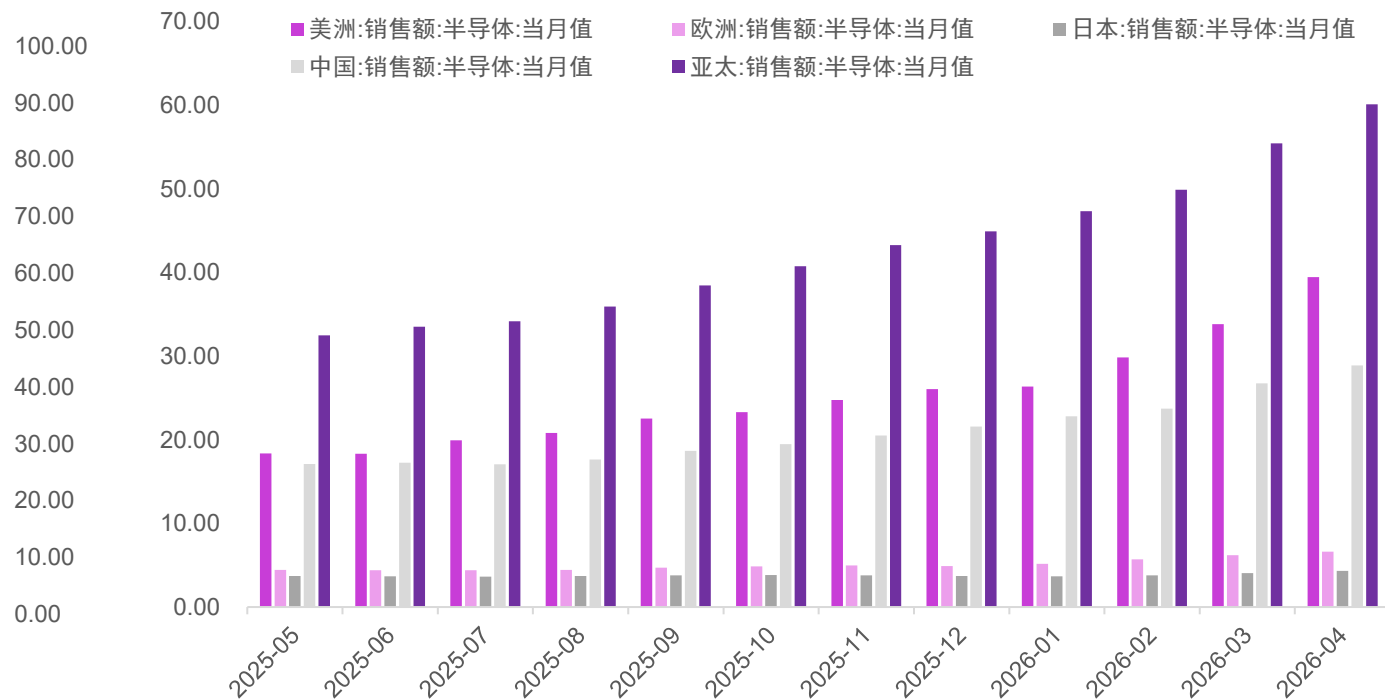
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年4月，全球半导体当月销售额为1104.80亿美元，同比增长93.89%。其中，中国销售额为288.80亿美元，环比增长8.00%，占比达26.14%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



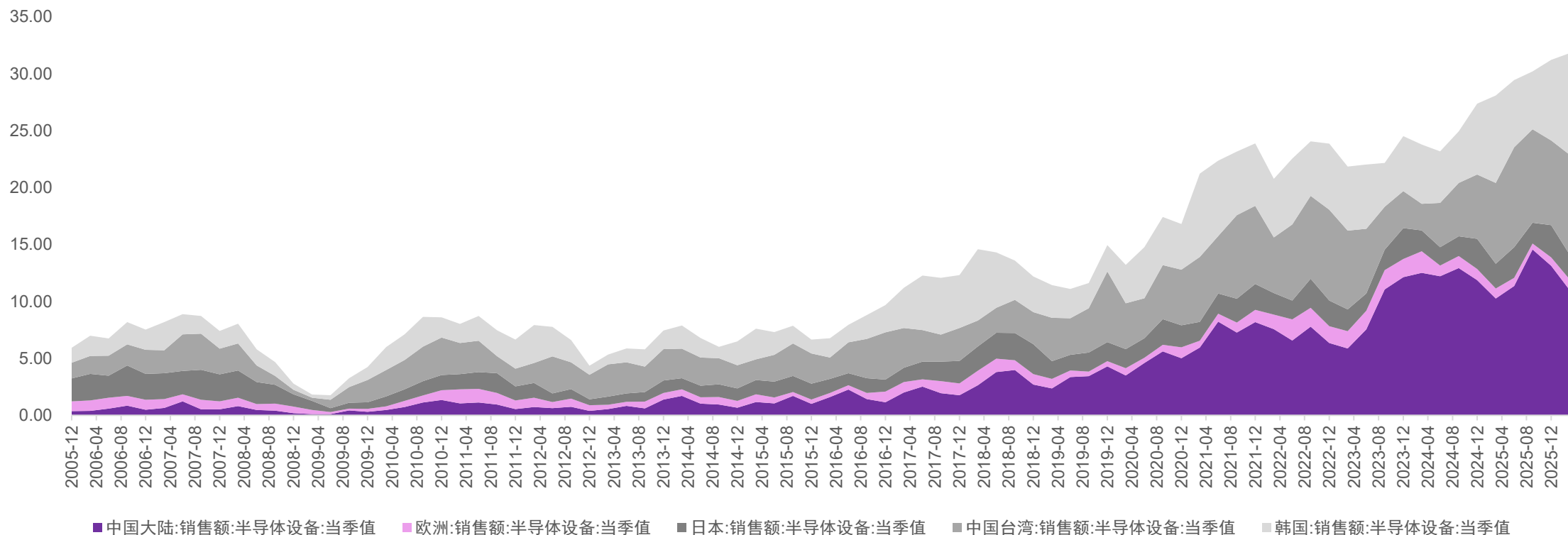
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.5、半导体：全球主要地区的半导体设备当季销售额

2005年以来，全球主要地区的半导体设备当季销售额呈现上升的趋势。2008~2009年，受全球金融危机等因素影响，各地区半导体设备销售额大多出现下滑。2020~2025年，随着5G、人工智能等技术发展带来的半导体需求增加，全球半导体整体呈现增长态势，中国大陆和中国台湾增长较为显著。

2026年一季度，中国大陆半导体设备销售额达到109.9亿美元，同比增长7.12%，环比下降16.30%，占全球主要地区比重达34.56%。

图表14：全球半导体设备销售额（十亿美元）

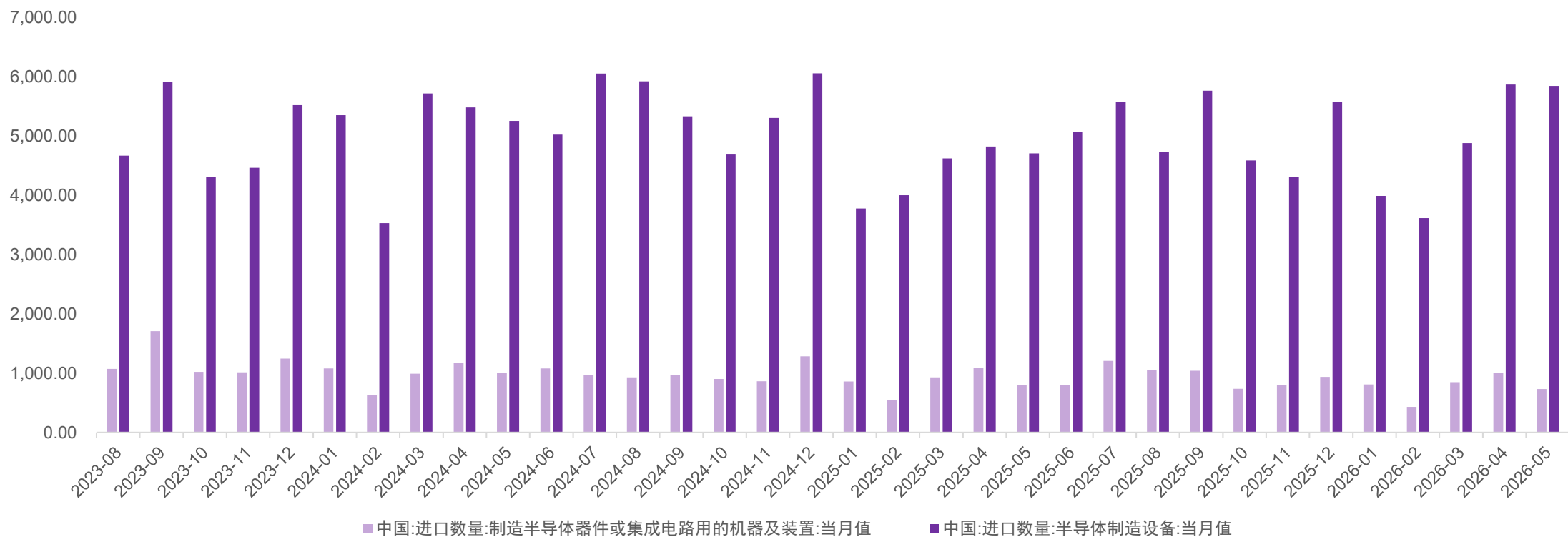


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。2026年1-2月进口数量阶段性回落，3月起持续回升，5月达5843台，4-5月连续两月维持在较高水平，显示国内晶圆厂扩产需求旺盛。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

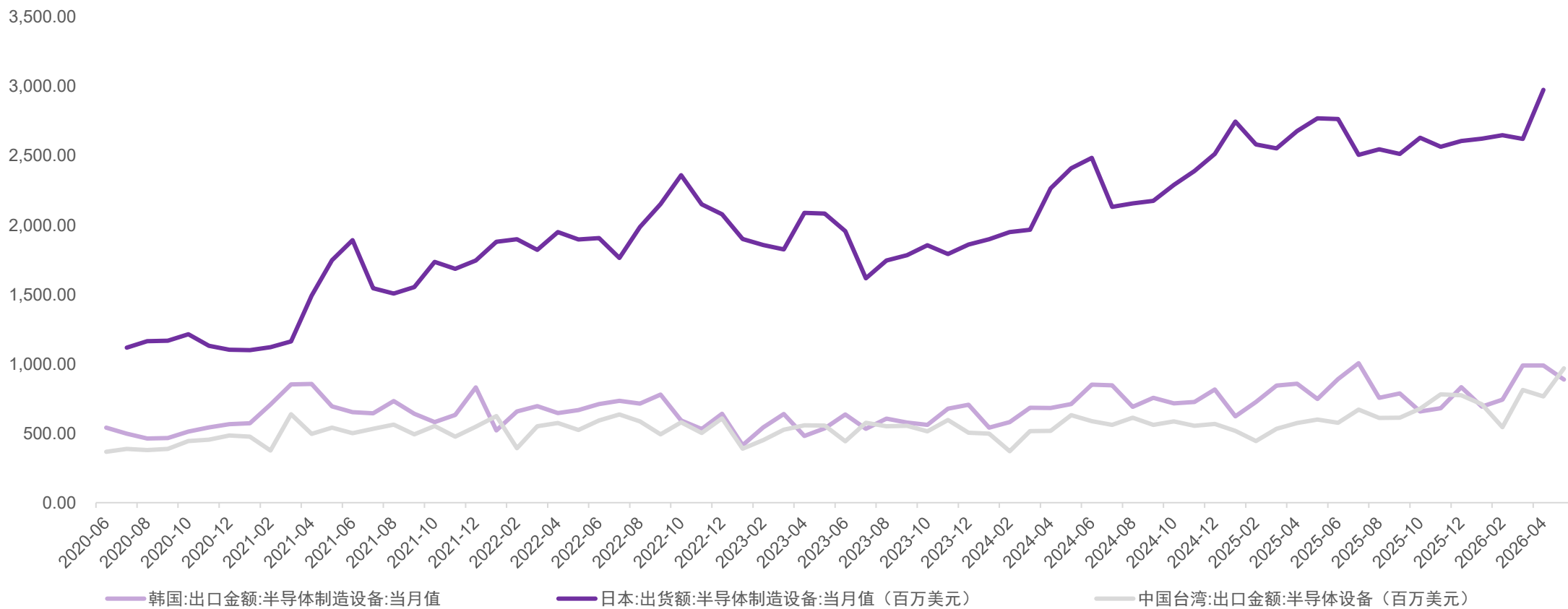


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。2026年以来，日本半导体设备出口额持续攀升并创阶段新高；韩国和中国台湾出口额近期高位有所回落。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

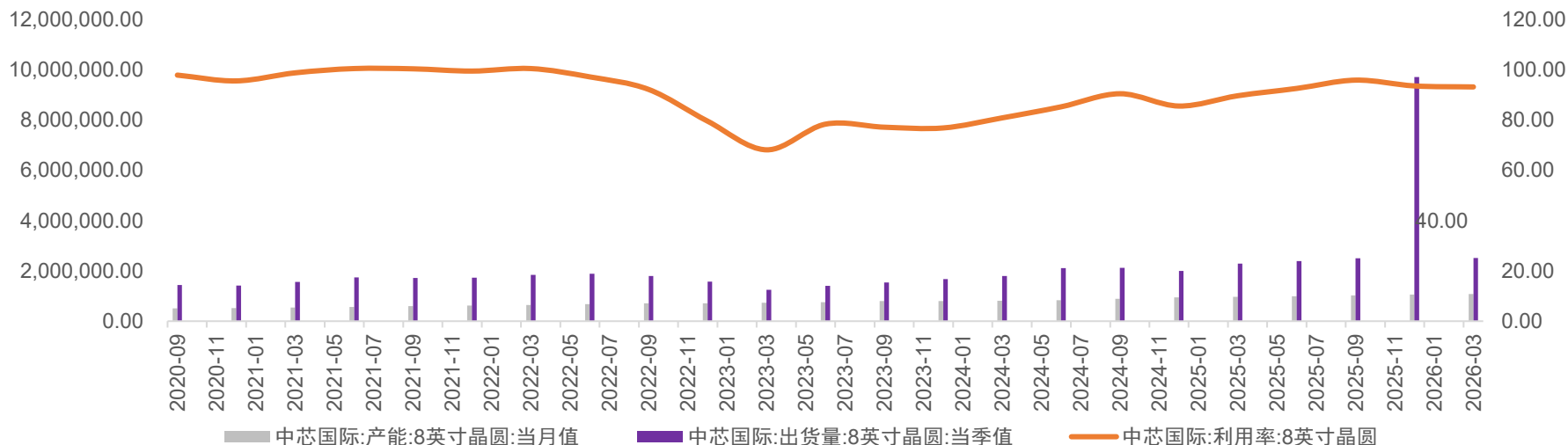
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2026年3月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约107.8万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度恢复至95.8%的高位，接近满产状态。随后2025年第四季度及2026年一季度分别回落至93.50%和93.10%，但仍处于较高水平。季度出货量方面，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高；2026年一季度约250.9万片，维持历史高位。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

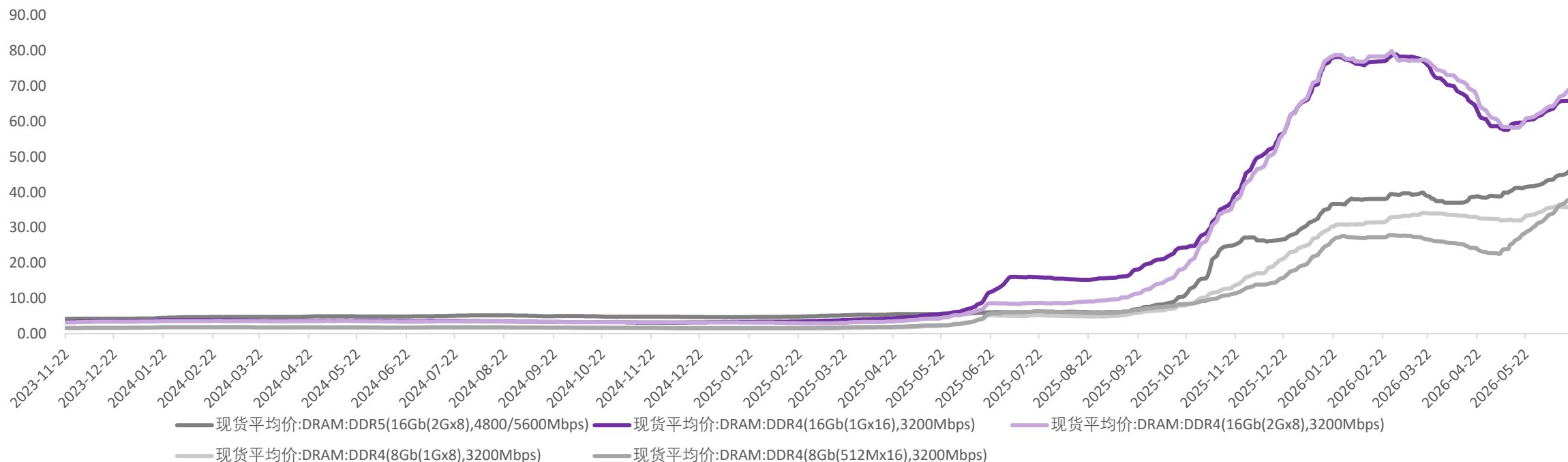


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI算力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年2月23日价格为17.95美元。DRAM方面：DDR5(16Gb,4800/5600Mbps)现货均价自2025年以来呈现大幅上涨态势，2026年3月初约39.67美元，此后延续上涨，截至6月18日价格已达46.00美元。DDR4各规格产品同步上行，16Gb(2Gx8)3200Mbps现货价由5月中旬的约58美元升至6月18日的69.13美元。整体来看，在AI需求拉动及供给端产能转向HBM的背景下，DRAM价格进入加速上涨通道。

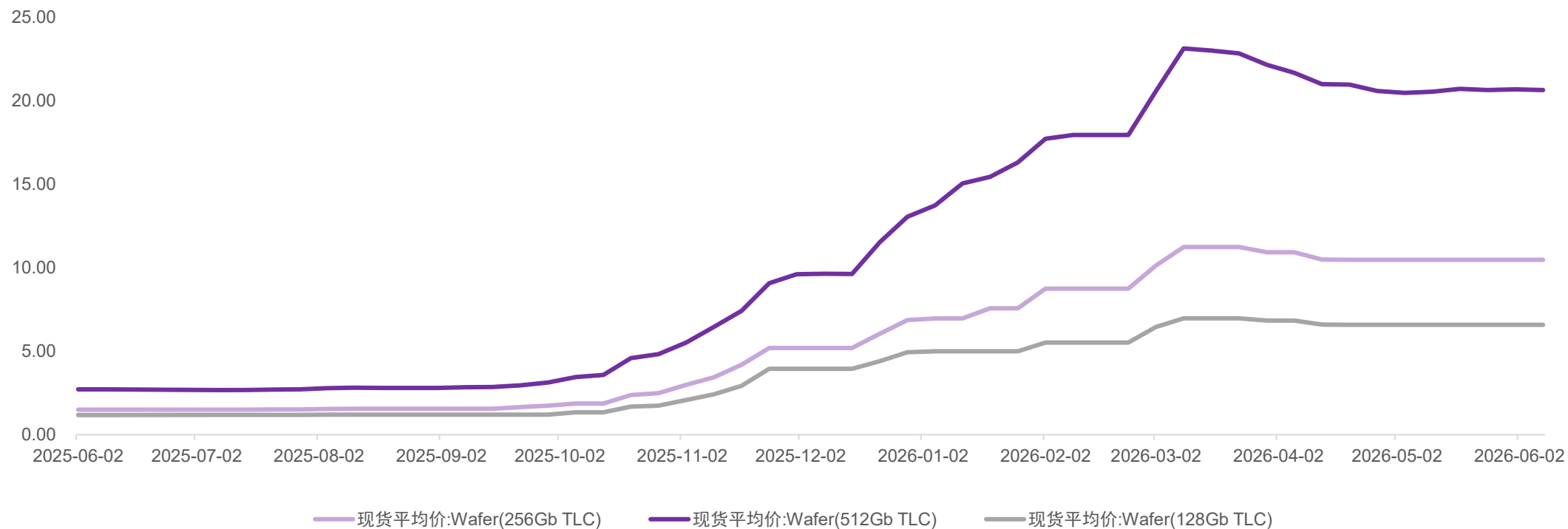
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

英特尔瞄准10倍增长目标，陈立武聚焦先进封装、玻璃基板和人工钻石技术

英特尔CEO陈立武近日在一场Podcast节目中表示，他为英特尔设定的回报目标是“5至10年内实现10倍增长”，同时正围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性重构公司的技术蓝图。陈立武透露，自上任以来的14个月间，已为英特尔股东创造约6倍回报，但他强调公司转型才刚起步。他预期到2030至2032年，外界才会真正认识到英特尔的潜力，范围不仅限于PC客户端这项传统核心业务，还将延伸至边缘计算、物理AI与AI代理（AI Agent）等新兴市场。他指出，若能有效整合英特尔的XPU产品线、先进封装技术与晶圆代工能力，将能针对不同工作负载提供定制化芯片方案，这正是他为公司锚定的长期战略方向。陈立武也提到，AI代理与推理应用的爆发式增长，正带动CPU需求强劲回升，数据中心服务器中CPU与GPU的配比，已从过去的1比8逐步演变为1比4甚至更低。

陈立武坦言，随着传统工艺节点微缩日益接近物理极限，英特尔已将技术布局的重心转向材料科学与先进封装。目前英特尔已量产18A制程，14A制程正在推进，并能看见10nm乃至7nm的技术路径，但他直言“这条路会越来越昂贵、越来越困难”。为突破瓶颈，陈立武在封装材料领域展开多项投资布局：

玻璃基板：投资玻璃基板公司3DGS，看中玻璃在散热与绝缘方面的独特性能。

先进封装：主推下一代芯片互连技术EMIB，并已宣布在印度与美国新墨西哥州推进先进封装制造合作专案。

新型半导体材料：在氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）三大方向均有投资，部分投资标的已被ADI等大型半导体企业收购。

人工合成钻石：投资一家钻石晶圆公司，看好钻石作为隔热材料在芯片封装中的应用潜力。

沪硅产业联合国资大股东投资114亿元，推动大硅片产业发展

在半导体国产替代浪潮愈演愈烈之际，国内大硅片龙头沪硅产业抛出了一份重磅增资计划。6月18日，沪硅产业（688126.SH）公告称，拟与持股5%以上股东上海国盛集团共同对子公司上海新昇半导体科技有限公司进行增资，合计增资金额高达114.48亿元，旨在全力推进300mm半导体硅片的产能升级。

一方面是上市公司的资产注入。沪硅产业拟以持有的新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权，总计作价约74.48亿元，认购上海新昇新增注册资本。

另一方面是大股东的强力支持。作为持股5%以上股东，国盛集团拟出资40亿元参与增资，其中10亿元以对上海新昇的借款本金实施债转股，另外30亿元以现金形式出资。

此次增资完成后，上海新昇的注册资本将由23.8亿元大幅增加至约42.83亿元。沪硅产业对上海新昇的持股比例将从100%下降至约84.48%，仍保持控股股东地位。

与此同时，国盛集团的40亿元资金被明确要求“专款专用”，将专门用于集成电路用300mm硅片产能升级。这不仅将加快产能建设和技术能力提升，也有助于沪硅产业进一步巩固国内领先地位，扩大市场份额。

全球最小晶体管，三星造

近日，三星电子实现了业界首款 42 纳米 (nm) 级 3D 堆叠晶体管，这是世界上最小的晶体管。三星电子半导体研究所逻辑技术开发团队于 17 日宣布，在最近于美国举行的VLSI 2026上展示了其在实现栅极间距为 42nm 的 3D 堆叠场效应晶体管（3D 堆叠

据三星透露，这项工作是在2026年超大规模集成电路（VLSI）研讨会论文评审过程中获得了8.29分（满分10分）的优异成绩，在1000多篇投稿论文中名列前茅，并荣获最佳论文奖。它还被选为2026年VLSI技术亮点之一。论文显示，这项研究的关键在于通过垂直堆叠晶体管来提高集成密度，而此前晶体管是放置在平面上的。虽然现有的逻辑半导体通过减小晶体管之间的间距提高了性能，但其局限性在于，当器件之间的绝缘层过薄时，会产生电干扰。

三星电子通过采用上下晶体管堆叠结构，实现了在同一面积内集成更多器件。该公司解释说，摆脱了水平绝缘膜厚度的限制，理论上可以将集成密度提高一倍。

尤其值得一提的是，它实现了42nm的栅极间距，比业界最小的48nm纪录还要精细。下晶体管的纳米片沟道也分别堆叠成三层（3/3层），并且首次在全球范围内应用了RBC（RX Bound@contact，接收端边界接触）结构，将上下器件垂直直接连接起来。

RBC工艺极其复杂，需要蚀刻出比传统旁路连接方法更深更窄的空间，并用金属填充。经过多次工艺改进，研发团队最终成功实现了这项技术。

这项研究的意义在于，它将之前在 V-NAND 和高带宽存储器 (HBM) 中使用的垂直堆叠概念应用于逻辑半导体。

半导体硅片迎资本热潮，国产硅片仍需平衡增长与盈利

近来，半导体材料领域特别是硅片行业受到资本市场青睐。多家A股上市硅片公司股价出现大幅上涨。这一方面缘于全球硅片市场需求的增长，更主要的是国产替代加速，资本市场高度看好国产硅片公司的长期发展前景。然而，国产硅片公司目前仍多处于高投入期，从一季度财报来看，多家公司仍处于亏损状态。因此，国产硅片企业在寻求发展、扩大产能、保持创新能力的同时，也需寻找创新投入与盈利的平衡点，以期早日实现盈利状态的改善。

2026 年开年以来，A股半导体硅片板块持续走涨为半导体材料领域的领涨板块。数据显示，截至 2026 年6月10日，7家核心硅片上市公司股价均实现正增长，其中3家公司半年涨幅接近翻倍。

具体来看，立昂微以91.91%的区间涨幅领跑行业，西安奕材紧随其后，涨幅达91.38%，有研硅也收获了86.78% 的亮眼表现。作为国内12英寸硅片龙头的沪硅产业，同期涨幅达到46.09%。上海合晶、神工股份和TCL中环分别实现了28.74%、21.55% 和16.04%的上涨，整体跑赢同期大盘多数板块。

这轮上涨并非A股独有现象，全球硅片龙头企业同样迎来估值重构。年初至今，法国SOITEC 股价累计涨幅超480%，日本SUMCO、中国台湾环球晶圆涨幅均超60%，显示出全球资本市场对硅片行业景气度全面反转的一致预期。

恩智浦推出SA

6月17日，恩智浦半导体正式发布SA
多重突破，精准匹配当下新能源汽车平台对车载雷达大规模搭载的市场需求。

这款全新雷达SoC采用自研创新射频设计方案，核心兼顾高性能探测与低功耗运行两大特性。在自动驾驶感知场景中，芯片可稳定输出高精度目标探测能力，同时控制整机功耗水平，缓解车载供电系统负荷，适配长期工作的车载感知硬件使用环境。

从整车开发落地层面来看，SA
机热管理配套设计，减少外围散热元器件使用，降低雷达模组在车身内部的装配、集成难度，同步压缩物料与生产加工环节，直接降低整套雷达感知系统的综合开发与制造成本。

当前新能源汽车智能化进程提速，高阶辅助驾驶、全域安全感知推动车载毫米波雷达装配数量持续提升，车企普遍追求低成本、易集成、高能效的雷达芯片方案。传统多芯片分立雷达方案存在结构复杂、散热设计难度高、综合成本偏高的痛点，而SA

业内分析表示，车载雷达是自动驾驶核心感知硬件，新能源车型雷达装配率持续走高，高集成单芯片雷达SoC成为行业主流发展方向。恩智浦SA
案，助力新能源汽车高阶智驾功能快速普及落地。

汤臣倍健5000万跨界投资AI芯片公司原粒半导体

6月18日，汤臣倍健公告称，拟以自有资金5000万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司，投资完成后将持有其0.97%股权。

根据公告，汤臣倍健以5000万元认购原粒半导体新增注册资本20,326元，获得其0.9671%股权，剩余部分计入标的公司资本公积。原粒半导体成立于2023年4月，是一家基于Chiplet（芯粒）技术的AI推理芯片初创企业，致力于为边缘端大模型部署提供高性价比的算力解决方案。

从财务数据看，这家成立仅三年的芯片公司尚处早期投入阶段：2025年全年营业收入约379.66万元，净利润亏损约6295.9万元；2026年一季度营收为0，净利润亏损约1091.5万元。

这笔跨界投资因涉及关联关系而格外引人关注。公告显示，公司董事长梁允超的配偶栾晓华间接持有原粒半导体股权，根据相关规定，本次投资构成关联交易。栾晓华住所位于中国香港，被认定为公司关联自然人。

对于这家保健品龙头为何“跨界”芯片，汤臣倍健表示，本次投资属于财务性投资，半导体领域是科技创新的重要方向，公司旨在通过投资布局建立对前沿科技领域的认知窗口，分享科技企业成长带来的中长期价值提升，为公司及股东创造良好的财务回报。

公司核心团队背景颇为亮眼——创始人兼CEO方绍峡博士曾任AMD芯片研发总监、Xilinx AI处理器研发总监，团队具备多代AI芯片研发经验与完整工程化能力。公司基于Chiplet模块化设计理念，打造积木式AI推理芯片，旨在让千亿参数大模型能在本地流畅运行，瞄准的是端侧AI推理这一快速增长的市场。

04 公 司 公 告

研究创造价值

台基股份:2025年年度权益分派实施公告

根据湖北台基半导体股份有限公司2025年年度权益分派实施公告。

公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本236,531,371股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利35,479,705.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次分派对象为：截止2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

华润微:2025年年度权益分派实施公告

根据华润微电子有限公司2025年年度权益分派实施公告。

本次利润分配方案经华润微电子有限公司2026年5月22日的2025年年度股东会审议通过。分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。分配方案为本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,328,210,680股为基数，每股派发现金红利0.051元（含税），共计派发现金红利67,738,744.68元（含税）。

分配实施办法：

- 1.除自行发放的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
- 2.自行发放对象：公司股东华润集团（微电子）有限公司和华润股份有限公司的现金红利由公司自行派发。

敏芯股份:关于调整2025年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

根据苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于调整2025年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告。

- 1.现金分红总额：苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）不变，派发现金红利总额由15,020,665.65元（含税）调整为15,021,280.71元（含税）。
- 2.资本公积转增股本总额：公司2025年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股不变，转增股本的数量由22,252,838股调整为22,253,749股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
- 3.本次调整原因：公司因2022年股票期权激励对象进行自主行权并完成股份登记，使得公司股本总数由56,057,494股增加至56,059,772股。公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数由55,632,095股调整为55,634,373股。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

炬芯科技:2025年年度权益分派实施公告

根据炬芯科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告。本次利润分配方案经炬芯科技股份有限公司2026年5月19日的2025年年度股东会审议通过。

本次分派对象为：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(炬芯科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

本次差异化分红送转方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），资本公积不转增，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174,280,495股，以此计算合计拟派发现金红利45,312,928.70元（含税）。公司回购专用证券账户所持有本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。根据公司于2026年5月28日披露的《关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告》，因公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属已完成，本次归属股份235,425股来源于公司回购专用证券账户回购的股票。根据公司2025年度利润分配方案，本次利润分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份651,730股，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174,515,920股，以此计算合计拟派发现金红利45,374,139.20元（含税）。

海光信息:2025年年度权益分派实施公告

根据海光信息技术股份有限公司2025年年度权益分派实施公告。本次利润分配方案经海光信息技术股份有限公司2026年4月28日的2025年年度股东会审议通过。

本次分派对象为：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

本次差异化分红方案为：根据2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本为2,324,338,091股，扣除回购专用证券账户中的股份数4,725,316股，本次实际参与分配的股本数为2,319,612,775股，拟派发现金红利总额34,794.19万元（含税）。

公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

根据2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=
(2,319,612,775×0.15000) ÷ 2,324,338,091 ≈ 0.150元（含税，保留小数点后3位）。

综上，公司本次权益分派除权除息参考价格=前收盘价格-0.150元 / 股。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值